

株式会社フジミインコーポレーテッド

株主通信 2010年12月発行

# FUJIMI TODAY

Vol.  
31

2010.4.1~2010.9.30



SPECIAL 特集 FEATURE

## フジミの技術について語ります

つよく、やさしく、おもしろい

# FUJIMI

証券コード 5384

# 次なる成長に向けて 体制を構築

皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

当上半期における世界経済は、中国やインドをはじめとする新興国の持続的な成長やエコポイント制度などの国内経済政策によるデジタル家電製品などの需要に支えられ、在庫積み増しも一巡し、回復基調で推移しました。しかしながら、欧米の景気減速、円高の進行や国内経済政策の縮小などの不安材料は多く、先行きは不透明な状況にあります。

こうした中、当社グループは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めた結果、当上半期の業績は、売上

高16,137百万円(前年同期比26.7%増)、うち製品売上高15,905百万円(前年同期比26.6%増)となりました。また利益面では、営業利益1,691百万円(前年同期は55百万円)、経常利益1,729百万円(前年同期比860.7%増)、累計の四半期純利益1,134百万円(前年同期は95百万円)と増益となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、ウェハーの堅調な需要に支えられ、ラッピング材の売上高は1,912百万円(前年同期比31.7%増)、ポリシング材の売上高は4,099百万円(前年同期比14.7%増)となりました。

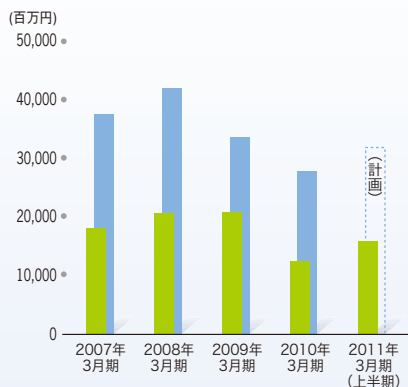
半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP(化学的機械的平坦化)向け製品につきましても、国内外のデバイスメーカーへの出荷が引き続き堅調に推移し、売上高は4,471百万円(前年同期比38.6%増)となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、一部在庫調整の動きはあったものの、ハードディスクの堅調な需要に支えられ、売上

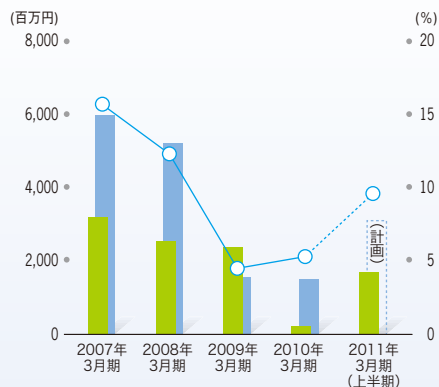
## 連結決算ハイライト

■ 上半期 ■ 通期 ○—○ 実績 ○—○ 計画

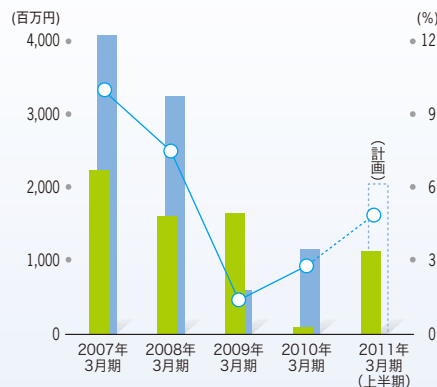
### ▶ 売上高



### ▶ 営業利益・売上高営業利益率



### ▶ 当期純利益・ROE



高は1,581百万円(前年同期比43.0%増)となりました。

下半期については、冒頭申し上げたように不安材料が多く、先行きは不透明ですが、引き続き売上の拡大とコストの削減に注力して参りたいと存じます。

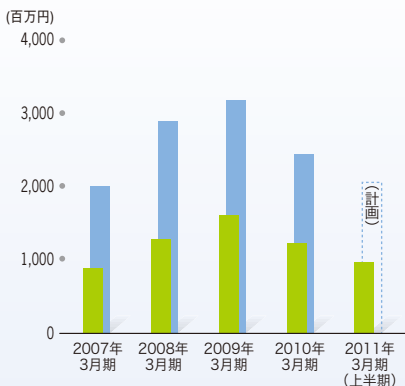
中長期経営計画二年目の今年は徐々に、新たな成長のための体制が構築されつつあります。当社の目標でもある『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して、企業風土の変革の動きを定着させ、より確かな動きとすることで、中長期計画の第一段階である成長への基礎固め・体制づくりの完了につなげていきたいと思ひます。引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



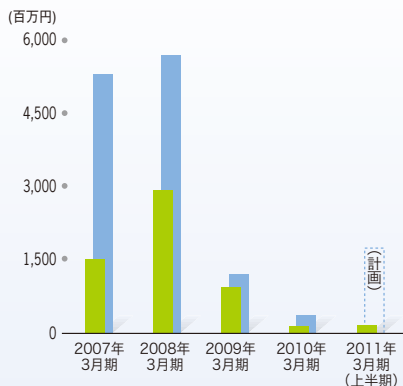
代表取締役社長

## 関 敬史

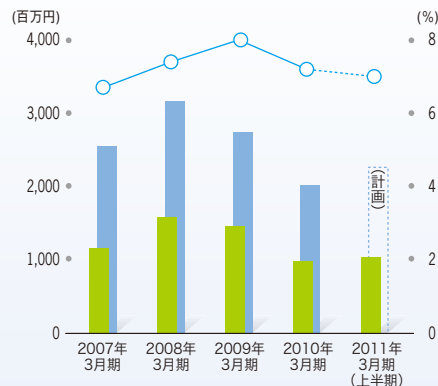
### ▶ 減価償却費



### ▶ 設備投資額



### ▶ 研究開発費・対売上高比率



# フジミの技術について 語ります

—森永 均 技術本部長に聞く—

フジミはなにをやっている会社なのか。フジミはどのような製品をどのような産業に提供しているのか。フジミの技術の強みはなにか。毎号株主様よりいただく貴重なご意見やご質問のなかには、技術に関するものがかなりのウエートを占めています。株主様の声を受けて、今回は“技術のフジミ”を担う技術本部長にフジミの技術とその強みについて聞きました。

## エッチング

表面の一部もしくは全面を化学薬液やガスで溶解する表面加工の技法。化学薬品の水溶液を用いるウェットエッチングと、ガスを用いるドライエッチングがある。

## CVD

Chemical Vapor Depositionの略。反応性ガスの化学反応を利用した薄膜形成方法。半導体素子の製造工程や切削工具の表面処理などで使用される。

## ワイヤーソー用砥粒

シリコンの塊などを切断する際に用いられる砥粒。

## ラッピング材

工作面を精密な平面に仕上げる研磨材。

## ポリシング材

ラッピング材よりもさらに細かい砥粒と薬液を配合した研磨材で、最終仕上げに使われる。

## ナノ

1ミリの百万分の1が1ナノ。

## Q1 事業アイデンティティには「表面加工分野で世界最高技術を」とありますが、表面加工とはどのようなものですか。

森永 表面加工には、①磨く(研磨)、②削る(研削)、③溶かす(エッチング)、④洗う(洗浄)、⑤膜をつける(めっき、CVD、溶射などの成膜)などの分野があります。

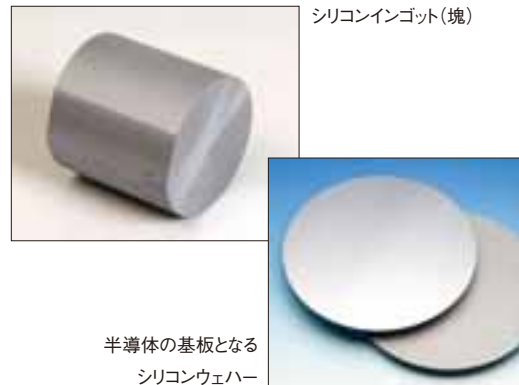
表面加工の方法は、大きく分けて2種類あり、1つはウェットプロセスといい、水を使います。水には、ものを分散させたり、溶かしたりする特異な性質がありますので、研磨、研削、エッチング、洗浄、めっきなどに広く用いられています。石を磨いてオノや矢ジリにした大昔の技術もその1つです。低コストでどんな表面にも適用できるのが特徴です。もう1つはドライプロセスといい、水を使わないで、材料を高温で分解し、表面に付着させる、あるいは表面から除去する手法です。溶射のように高温で材料を溶かして成膜するのもドライプロセスです。数百度から数万度の高温で処理するため、高いエネルギーが必要ですが、ウェットプロセスではできない特殊な加工が可能です。ドライエッチング、CVD、溶射などが含まれます。

## Q2 フジミの技術は、どのような産業のどのようなものづくりに使われているのでしょうか。

森永 フジミのお客様の半分以上は半導体業界で、半導体ができるまでのいくつもの工程で使われています。

代表例としてパソコン、テレビ、携帯電話、自動車などに多数の半導体が組み込まれています。半導体の基板(ウェハー)は、シリコンの塊を卵切り器のようなワイヤーで輪切りにして作ります。その際、ワイヤーソー用砥粒を用いて薄く切ります。よく見ると切ったあとの表面はギザギザになっているので、ラッピング材と呼ばれる粒子径数ミクロンの粉でガリガリ削ります。そのあともまだ表面が荒れているので、薬液で表面を溶かして、最後にポリシング材というコロイダルシリカを用いた研磨材で磨いて仕上げます。こうして半導体用のシリコンウェハーが作られます。

次は半導体デバイス。シリコンウェハーの上に、ナノの世界で微細な回路を形成した電子部品のことで、産業



半導体の基板となる  
シリコンウェハー

のコメとも言われています。1円玉くらいの小さな部品(チップ)ですが、たくさんの情報を詰め込んで、さまざまな仕事ができるよう高集積化が進んでいます。最新のものと、小さなチップの中に新聞紙数百万枚分の情報が入ります。半導体の回路を作っている配線の幅は50ナノメートル位。髪の毛の直径の1/2000という精密なもので、この配線層が10階建てくらいに積み上げられています。問題は配線を積み上げる際に凹凸ができてしまうことです。そこで、配線を積むたびに凹凸を取り除くのに、**CMP技術**が用いられます。ここでもシリコンウェハーの最終仕上げ材の知見を活かした**CMPスラリー**が使用されています。

また、パソコンやDVDレコーダーなどに入っているハードディスク(円盤状の磁気ディスク)の研磨にもポリシング材が使用されています。

**溶射材**は、熱・磨耗・衝撃に強い皮膜で、建設機械や半導体製造装置などの装置に用いられています。当社の中では新しい製品です。



ハードディスクドライブ(上)とハードディスク(下)

### Q3 研磨におけるフジミの技術的な優位性にはどのようなものがありますか。

**森永** 研磨には5つの要件があります。①平坦化(平らにする)、②平滑化(なめらかにする)、③無欠陥化(欠陥をなくす)、④無汚染化(汚れを残さない)、そして、⑤高

効率化(生産性の向上)です。フジミの製品は、この5つのいずれにおいてもお客様から高い評価を得ています。最終研磨で大切なのは、キズ、ゴミ、表面荒れなどの欠陥を残さないこと。フジミが開発した最新の研磨材では、従来品と比べ欠陥の数を1/10に減少させました。最終研磨では、研磨材の粒の中に1個でも大きな粒が入ると、そこに圧力が集中してキズの原因になりかねません。研磨材中のすべての粒子のサイズが均一であることが求められます。これを可能にするのはフジミが得意とする**ろ過・分級技術**です。研磨や研削の途中で出た削りカスが凝集してキズの原因になることもあります。削りカスを分散し、溶かす薬液などの**ケミカル技術**もフジミの大事な技術です。

また、高効率な研磨を実現する上で欠かせないのが**パウダー技術**です。砥粒には同じ大きさでもさまざまな形や硬さのものがあって、研磨能率はそれによって何倍も何十倍も変わります。研磨に適した砥粒を設計・選定し、安定供給するためには、研磨性能や粒子の評価技術も欠かせません。当社のスラリーの中には数十ナノメートルの粒子が何百億も入っています。その中から1~2個の大きな粒を探すという検査技術も当社ならではのものかもしれません。

### Q4 事業拡大に向け新規事業分野にも注力していると思いますが、技術本部長が考える構想をお聞かせください。

**森永** 図1(次頁)は新規事業のテーマを野球のストライクゾーンをイメージして作ったものです。ヨコ軸は市場。左から半導体・ディスクなどのフジミにとっての既存市場。真ん中が今後の成長が期待される周辺市場。右がその他の市場です。タテ軸は技術。上がフジミの既存技術。真ん中は新たに開発する周辺技術。下が当社にとって全く新規の技術です。

森永 均 技術本部長

**CMP**  
Chemical Mechanical Planarizationの略。薬液の化学的作用と砥粒の機械的作用を利用した、研磨による平坦化技術。

**CMPスラリー**  
CMP用のポリシング材。

**溶射材**  
熱や磨耗、腐食などに対する強度を高めるための表面コーティングに用いられる金属やセラミックなどでできた素材。

**ろ過・分級技術**  
大きさの異なる粒子を流体の中で沈降速度の差を利用して分け(分級)、さらにフィルターを組み合わせると一定のサイズ以上の粒子を確実に捕捉する(ろ過)技術。

**ケミカル技術**  
分散・溶解・表面保護などの一定の機能を持つ薬液を設計・選定する技術。

**パウダー技術**  
用途に適した一定の機能を持つ粒子の設計・製造・選定・評価技術。



## 新規事業・テーマの探索・推進【図1】

	市場		
	既存 (中核)	周辺 (環境・エネルギー 分野など)	その他 (衣食住・医療・ 娯楽など)
技術	<b>既存 (商品/技術)</b> 打率: 0.5 ・半導体用スラリー ・ディスク用スラリー ・ラッピング材 など	打率: 0.3 → 用途拡大	打率: 0.2 → 新用途開拓
	<b>開発 (周辺技術)</b> 打率: 0.3 ・半導体用○○ ・ディスク用○○ など	打率: 0.25 ・LED用○○ ・太陽電池用○○ ・FPD用○○ など	打率: 0.15 ・ろ過・分級技術応用 ・パウダー技術応用 など
	<b>新規</b> 打率: 0.2	打率: 0.1	打率: 0.01



### LED

Light Emitting Diodeの略。順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のことで発光ダイオードと呼ばれる。省エネの照明などに用いられる。

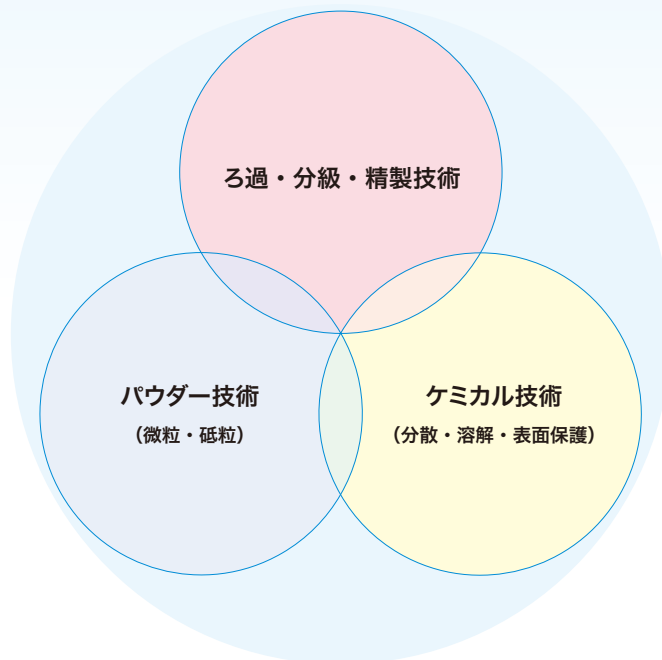
今のフジミは、既存市場と既存技術が重なるところでは高い確率でヒットを打てますが、そこだけ打っていても10年後も安泰というわけにはいきません。フジミがさらに事業を拡大するには、今とは違うことにも挑戦しないとはいけません。「フジミの強みが発揮でき」、お客様から見ても「なるほどフジミらしい」と思わせる分野への展開が成否のカギを握っていると思います。

Q5

新規事業に应用できるコア技術にはどのようなものがありますか。

森永 フジミには、図2で示すように大きく分けて「ろ過・分級・精製技術」「微粒・砥粒をつくるパウダー技術」「分散・溶解・表面保護などを行うケミカル技術」からなる3つのコア技術があります。新規事業はこれらを組み合わせ、優れた技術を創出することによって可能にな

## フジミのコア技術【図2】



と考えています。実は、3つを無理やり組み合わせるのではなく、2つを組み合わせるだけでも、十分新しいものができると思っています。

大事なコア技術にはさらに磨きをかけていきたいですし、新規事業推進の上で、この3つのほかに不足している技術があるなら、新たな技術の獲得にもチャレンジしていきたいと思っています。

Q6

営業や製造など他の部門との連携はどのように進められていますか。

森永 他部門と連携を図るため、先期から今期にかけて新たな体制を作りました。開発の流れに沿って話をすると、例えば、ハードディスクの開発チームにいきなりLED用スラリーの開発はできません。そこで市場に向けた「開発企画課」を立ち上げました。営業からの需要はここに

集まり、それを開発テーマとして取り上げるかどうかの議論が始まります。もう1つ、新規事業の創出プロジェクト(Nプロジェクト)を発足させました。技術部門、営業部門、企画部門を中心とする約15名で構成されており、関係部門が一緒になって新しいものを考える仕組みです。また、新規の技術はコアな技術があってこそ広げていけるので、基礎技術を固める「基盤技術課」を新設したほか、コア技術を生産現場に使える技術に仕上げ、その窓口となる「プロセス開発課」と「量産技術課」を新たに設けました。量産技術は実際の工場の生産現場で作り込み、製品化します。そうすることで製造とのコミュニケーションも密にとれ、より連携が図れると考えます。

## Q7 有望なテーマがありましたらお聞かせください。

森永 これからの成長分野に環境エネルギー分野があります。代表例として、LED、太陽電池、バッテリーなどです。世界的なCO<sub>2</sub>削減の動きと相まって期待が高まっています。リーマンショックでほとんどの事業が低迷する中、世界市場でのLEDはこの1年で1.5倍も成長し、当社のLED用研磨材は1.7倍の伸びを示しました。

世界の照明の市場規模は、2020年で20兆円といわれています。これは、現在の半導体デバイスの市場規模に匹敵します。LEDと白熱灯を比べるとエネルギー効率は5倍、CO<sub>2</sub>の排出量は1/5に。2012年までに日本が、2017年までに中国が、現在の白熱灯の生産を中止し、その多くがLEDに切り替わると予想されます。照明市場の半分くらいがあっという間にLEDに替わるのです。

LEDの基板にはサファイアが用いられています。サファイアはシリコンに比べて硬く、磨く時間が10倍かかっているため、研磨能率の向上が求められています。現在、フジミのサファイア用スラリーは国内ではかなりのシェアを占めており、今後は大きな設備投資をすると予想される韓国・台湾メーカーにどれだけ対応できるかがポイントです。

## Q8 今期中長期経営計画の(種まき(基盤整備))にあたります。技術本部ではどのような方針の下、どのような課題に取り組んでいますか。

森永 技術本部は3つの方針を打ち出しています。

### ①「コア技術を磨いて強くなる」

フジミはあらゆる部材に対応する世界唯一の研磨メーカーです。ところが部材ごとにチームが生まれ、それぞれに過・分級や砥粒などの開発を行ってきたため、お客様に対して、十分な対応が取れていない場面がありました。これからは、大事なコア技術は基盤技術課が磨き上げ、それを横展開する方法に切り替えることにしました。

### ②「開発効率を高める」

開発効率を高めるため、チームごとにインプットとアウトプットの評価をします。商品開発に対しては基盤技術を担うメンバーや量産技術を担うメンバーを別途設け、お客様への対応や開発に集中できる体制も整えました。

### ③「企画能力の向上」

コア技術を理解した上で、市場を360度見わたせる発想や情報収集のあり方を確立します。その核になるのが「Nプロジェクト」と「開発企画課」です。

## Q9 本部長が期待するスタッフ像を教えてください。

森永 技術部門は、科学の原理原則をしっかり見つめ、それを基本に技術開発を進めなければなりません。有史以来の歴史を持つ研磨や表面加工には経験や勘でここまで来ているところがたくさんあります。これを「科学」にすることが目標の一つです。ムリ・ムラ・ムダのない製品や技術には、欠かせないと考えています。開発スタッフには、「強く、柔軟な人になって欲しい」と日々語ってきました。柔らかな頭をもち、人の意見を聞き、世の中のことをきちんととらえる。ただし、強い人でなければ、技術の本質を見極め、新たなものを作ることはできません。その原動力は「好奇心」であり、「夢」であると思っています。

## 太陽電池

光エネルギーを電力に変換する電力機器。シリコン太陽電池のほか、化合物半導体などを素材にしたものが実用化されている。

## バッテリー

蓄電池のこと。ガソリン車などが排出するCO<sub>2</sub>を減らすため、電気自動車の需要拡大が期待される。



## 皆様のご質問に社長がお答えします。

**Q** 設備投資と研究開発費が抑制傾向にありますか、一時的な動きでしょうか。理由を教えてください。

(40代・50代・60代男性ほか多数)

**A** 設備投資は新工場および製造ラインの増設を実施した2007年3月期と2008年3月期にそれぞれ50億円を上回りましたが、当面の能力を確保できたことから、2009年3月期と2010年3月期については、必要最低限の投資に抑えました。今期の設備投資は従来並みの20億円前後を予定しており、今後必要に応じ、適宜、設備投資を行っていく予定です。研究開発費については20～30億円台の投資を継続的に行っており、対売上高R&D(研究開発)比率では現在でも7～8%となっています。

**Q** 理想のフジミ像の中で「ニッチな業界でトップの企業」とありますが、どのような意味ですか。

(50代男性)

**A** ニッチは隙間市場とも訳され、大手などが進出しにくい専門的な市場との意味をもちます。当社のお客様(お取引先)は、エレクトロニクス産業など先端産業が中心です。ただし、当社の製品そのものは半導体ウェハーやハードディスク、電子デバイスなどの研磨という特定の需要をもつ規模の限られた市場が対象です。「ニッチな業界でトップの企業」とは、専門的な市場でのトップ企業という趣旨です。

**Q** アジアを中心とした海外進出についての方針を教えてください。

(50代男性・女性)

**A** 当社はアジア地域のマレーシアに子会社を持ち、一部製品の製造・販売を行っています。また、台湾、上海、韓国に事務所を設置し、営業および技術サポートを迅速に行える体制をとっています。ただ、エレクトロニクス産業、特に半導体分野ではアジアへのシフトが進んでおり、今後、お客様の動向に注意しながら、必要に応じてさらなる海外進出も検討したいと思います。

**Q** 「強く、やさしく、面白い」会社をめざすとあるが、「面白い会社」とはどのような会社を指すのですか。

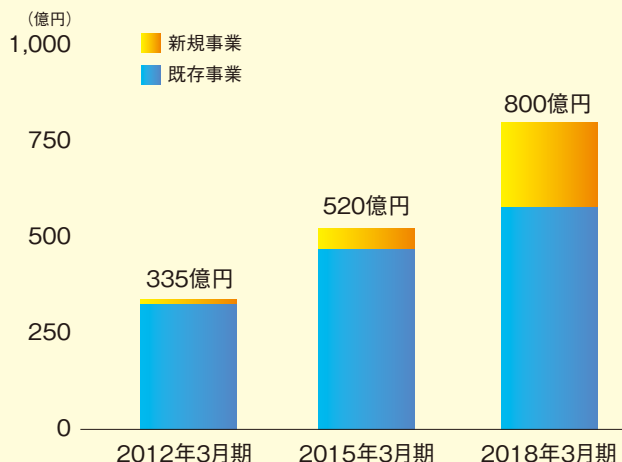
(60代男性・女性)

**A** 自由闊達であるとともに妥協せず、お互いが切磋琢磨することが会社を「強く」することだと思います。また、仲間を大切に、助け合い、感謝すること、これが「やさしい」会社であり、夢をいただき、夢の実現にむけて一人ひとりが活き活きと仕事ができることが「面白い」会社であると考え、目指す姿として掲げています。

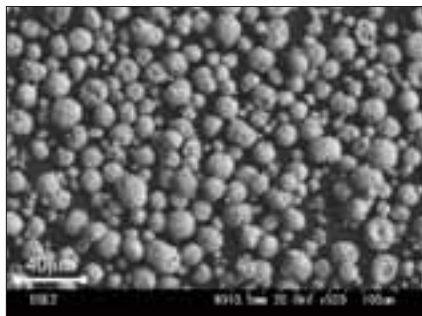
## Q 新中長期経営計画の3カ年ごとの数字を聞かせてください。

(60代男性)

A 3カ年ごとに右のグラフのような売上高を想定しています。持続的な成長には新たな中核事業の発掘育成が重要であり、2018年3月期に既存事業580億円に加えて、新規事業220億円を達成したいと考えています。



## NEWS & TOPICS ニュース & トピックス



WC-Fe基金溶射材料の電子顕微鏡写真

### 用語解説

**造粒焼結粉:** サーメット溶射材料の粉末タイプには熔融粉碎粉、焼結粉碎粉、ブレンド粉等がある。造粒焼結粉は熔融粉碎粉や焼結粉碎粉と比較すると粉末強度が低く、高い溶射効率を実現する。ブレンド粉と比較すると造粒焼結粉は流動性に優れており安定供給が可能であり、成膜時の硬質粒子脱落率が低い。

### 500°Cからの低温域で超硬成膜を可能とする溶射材料を開発

当社は、低温・高速の溶射プロセスで、500°Cからでも成膜可能なタングステンカーバイド(WC)系サーメット溶射材料の開発に成功し、9月中旬より用途創出・拡大に向けて生産を始めました。現在主流となっているWC溶射のプロセス温度は2000°C以上であり、より広汎に高硬度なWC溶射皮膜が使われることに期待しています。本開発品の特徴は細かい造粒焼結粉\*であることと、特殊な材料組成にあります。

当社では皮膜特性や溶射機に応じて最適化させた試作品の提供を行うことで、高速フレーム溶射では一部の代替に留まっている硬質クロムメッキの代替促進や現地補修用途等の分野に展開されることを期待しています。また、化石燃料による燃焼技術を用いない安全、クリーン、かつ低コストで硬質コーティングを成膜できるため、国内外のさまざまな分野に活用できるものと考えています。

# 用途別の動き

暮らしを楽しく、便利にするパソコン、携帯電話、DVDなどのデジタル家電。この心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右する重要なポイントです。フジミは、人造研磨材の専門メーカーとして、シリコンウェハーや半導体デバイスの製造工程に欠かせない研磨の分野で、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献していきます。



## シリコンウェハー用

パソコンを中心に、電子・IT 関連機器の心臓部に使用されている半導体部品の土台がシリコンウェハー（半導体基板）です。このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロニクス製品の性能を大きく左右します。当社の主力事業であるシリコンウェハー用製品は、ウェハーの堅調な需要に支えられ、ラッピング用研磨材とポリシング用研磨材を合わせ売上高は6,011百万円、前年同期比19.6%増となりました。

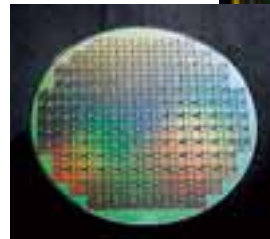


半導体の基板であるシリコンウェハー。現在の主流は、直径300mmの大口径となり、表面を高精度に磨き上げるために当社の超精密研磨材が使われています。

## CMP用

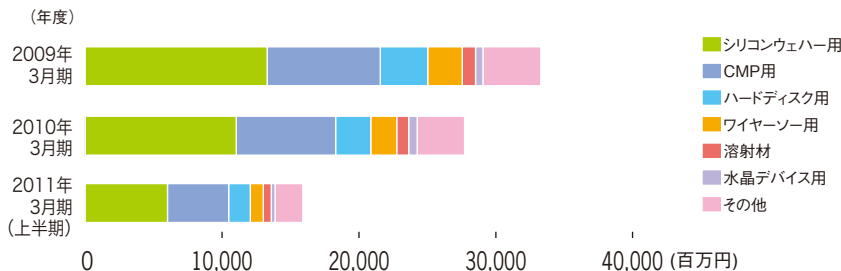
半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP（化学的機械的平坦化）用製品は、長年にわたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応用して開発された製品群です。エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求められています。その際に使用されるCMP用製品は、今後も引き続き高成長が期待される分野です。国内外のデバイスメーカーへの出荷が引き続き堅調に推移し、売上高は4,471百万円、前年同期比38.6%増となりました。

さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進展が加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細くなっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10~12層にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かせずことができます。

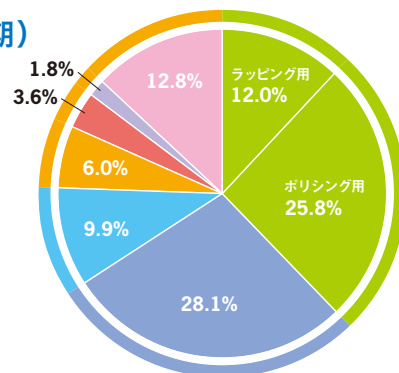


## 用途別製品 売上高推移

※グラフは商品を含めない自社製品のみの上高です。



## 2011年3月期(上半期) 事業別売上高比率



### ハードディスク用

ハードディスクは、パソコンの記憶装置としてはもちろん、ブルーレイディスク (BD)/DVDレコーダー、デジタルビデオカメラ、携帯音楽端末、カーナビなどにも搭載されています。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、ディスクの表面研磨は、シリコンウェハー同等もしくはそれ以上の面精度が要求されています。

一部在庫調整の動きはあったもののハードディスクの堅調な需要に支えられ、売上高は1,581百万円、前年同期比43.0%増となりました。



写真や映像を手軽に加工したいという市場ニーズが高まり、技術革新が進んだことで、パソコン、デジタルカメラ、携帯電話などのデジタル家電は、より多くの情報が記憶できるようになりました。それに伴い、記憶装置であるハードディスクの研磨面にも今まで以上の高いレベルが求められています。

### ワイヤーソー用、溶射材、水晶デバイス用、その他の用途

単結晶・多結晶のシリコンインゴット(塊)から厚さ1ミリ未満のウェハーに切断するため使用されるワイヤーソー用砥粒。主に半導体シリコンウェハー切断用や太陽電池用シリコンの切断に使われていますが、安価な中国品など新興国製品による影響から、売上高は951百万円、前年同期比2.8%増となりました。溶射材は、建設機械部品や鉄鋼分野の各種ロール、半導体製造装置など、耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性を高める用途に使われています。主力であるサーメット容射材及びセラミックス容射材を中心に製品の拡販に努め、売上高は580百万円、前年同期比39.0%増となりました。一方、水晶デバイス用は水晶振動子などの研磨に使われていますが、携帯電話や自動車向け需要はあったものの、市場価格下落の影響を受け、売上高は279百万円、前年同期比6.3%減となりました。



シリコンや太陽光発電用セルの切断、携帯電話・デジタルカメラなどでのスイッチや周波数制御をする水晶部品の研磨・切断にも当社製品が使われています。溶射材はさまざまな機械部品の耐久性を高める皮膜として注目されています。

# 連結財務諸表

## 売上高

中国やインドをはじめとする新興国の持続的な成長や、エコポイント制度などの国内経済政策によるデジタル家電製品等の需要に支えられ、回復基調で推移しました。しかしながら、欧米の景気減速、円高の進行や国内経済政策の縮小などの不安材料は多く、先行きは不透明な状況です。こうした中、半導体シリコンウェハー向け、CMP(化学的機械的平坦化)スラリー向けなど当社主力製品は堅調な重要に支えられ、売上高は前年同期比26.7%増の16,137百万円となりました。

## 営業利益

売上高の増加とともに、減価償却費の減少及び固定費の大幅なコスト削減などに努めた結果、売上原価率が7.5ポイントダウンし、営業利益は1,691百万円(前年同期は55百万円)と大幅な増加となりました。

## 上半期純利益

上半期純利益は、1,134百万円(前年同期は95百万円)となりました。(前年同期において、営業利益よりも純利益が多かった主な理由は法人税等還付税額があったこと等によるものです。)

(単位:百万円)

連結損益計算書	2010年3月期 (通期)	2010年3月期 (上半期)	2011度3月期 (上半期)
<b>売上高</b>	28,177	12,741	16,137
売上原価	20,573	9,703	11,085
販売費及び一般管理費	6,107	2,983	3,360
<b>営業利益</b>	1,496	55	1,691
営業外収益	225	139	65
受取利息/配当金	50	24	29
その他	174	114	35
営業外費用	22	14	28
支払利息	16	10	7
その他	6	4	21
<b>経常利益</b>	1,699	179	1,729
特別利益	220	35	53
特別損失	452	24	22
<b>税金等調整前上半期(当期)純利益</b>	1,467	191	1,760
法人税、住民税及び事業税	546	111	455
法人税等還付税額	—	△51	—
法人税等調整額	△255	28	160
少数株主利益	14	7	10
<b>上半期(当期)純利益</b>	1,161	95	1,134

※通期は4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。

(単位:百万円)

連結貸借対照表	2010年3月期 (通期)	2010年3月期 (上半期)	2011年3月期 (上半期)
<b>資産の部</b>			
流動資産	29,617	26,591	31,270
現金及び預金	13,835	11,607	15,321
受取手形及び売掛金	8,027	7,405	8,041
たな卸資産	4,676	4,834	4,935
その他	3,188	2,982	3,096
貸倒引当金	△110	△238	△123
固定資産	17,844	19,485	16,850
有形固定資産	15,239	16,724	14,392
無形固定資産	331	341	320
投資その他の資産	2,273	2,420	2,137
資産合計	47,462	46,076	48,121

※通期は年度末の3月31日現在。上半期は9月30日現在。

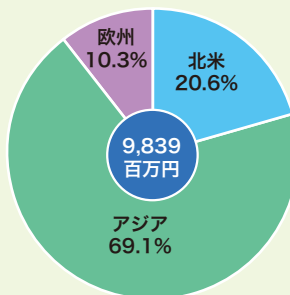
(単位:百万円)

連結貸借対照表	2010年3月期 (通期)	2010年3月期 (上半期)	2011年3月期 (上半期)
<b>負債の部</b>			
流動負債	5,763	4,090	5,970
支払手形及び買掛金	3,335	2,246	3,672
短期借入金	184	364	88
その他	2,243	1,479	2,209
固定負債	271	327	254
負債合計	6,035	4,418	6,225
<b>純資産の部</b>			
株主資本	42,170	42,216	42,873
資本金	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	35,111	34,482	35,815
自己株式	△2,764	△2,089	△2,764
評価・換算差額等	△998	△806	△1,243
新株予約券	63	60	61
少数株主持分	191	187	203
純資産合計	41,426	41,658	41,895
負債純資産合計	47,462	46,076	48,121

(単位:百万円)

海外売上高	2010年3月期 (上半期)	2011年3月期 (上半期)
海外売上高	6,975	9,839
連結売上高	12,741	16,137
連結売上高に 占める割合	54.7%	61.0%

海外売上高構成比(2011年3月期上半期)



\* 各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

北 米: 米国、カナダ

アジア: 台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

欧 州: ドイツ、イタリア、イギリス

# 連結財務諸表

(単位:百万円)

## ● 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、2,278百万円となりました。これは主に、税金等調整前上半期純利益が1,760百万円、減価償却費が962百万円及び仕入債務の増加額が397百万円など資金の増加項目が、たな卸資産の増加額が327百万円及び法人税等の支払額が500百万円など資金の減少項目を上回ったことなどによるものです。

## ● 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は、354百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が501百万円及び有形固定資産取得による支出が205百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が1,000百万円あったことなどによるものです。

## ● 財務活動によるキャッシュ・フロー

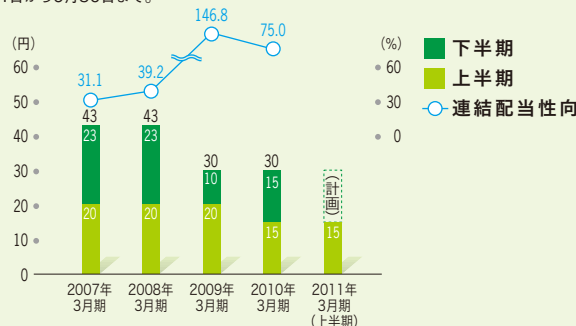
財務活動の結果使用した資金は571百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額91百万円及び配当金の支払額が431百万円あったことなどによるものです。

## ● 配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては、安定配当にも留意し30%以上の連結配当性向を目標として、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいりました。このような方針のもと、当上半期の配当金は1株につき15円とし、年間配当金については、1株につき30円を予定しています。

連結キャッシュ・フロー計算書	2010年3月期 (通期)	2010年3月期 (上半期)	2011年3月期 (上半期)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	6,768	3,128	2,278
税金等調整前上半期(当期)純利益	1,467	191	1,760
減価償却費	2,448	1,231	962
売上債権増減額(△は増加)	△2,081	△1,406	△62
仕入債務増減額(△は減少)	856	△263	397
たな卸資産増減額(△は増加)	2,656	2,581	△327
その他	597	13	10
小計	5,944	2,348	2,740
利息及び配当金の受取額	51	35	38
利息の支払額	99	△10	△8
法人税等の支払額	△135	△65	△500
法人税等の還付額	—	763	9
その他	807	56	—
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△1,594	△71	354
定期預金の預入による支出	△1,500	—	△501
定期預金の払戻による収入	150	150	1,000
有形固定資産の取得に関する支出	△256	△182	△205
無形固定資産の取得に関する支出	△90	△30	△42
その他	102	△8	103
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△1,450	△117	△571
短期借入金の純増加(減少)額	37	209	△91
長期借入金の純増加(減少)額	△93	△47	△45
自己株式の取得及び売却による収支	△675	15	—
親会社による配当金の支払額	△729	△291	△431
その他	10	△2	△3
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	17	72	△78
<b>現金及び現金同等物の増加(減少)額</b>	3,740	3,011	1,983
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	10,899	10,899	14,639
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	14,639	13,910	16,623

※通期は4月1日から翌年3月31日まで。上半期は4月1日から9月30日まで。



## 株式情報 2010年9月30日現在

### 株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000千株
	発行済株式総数	30,699千株
	株主数	6,493名

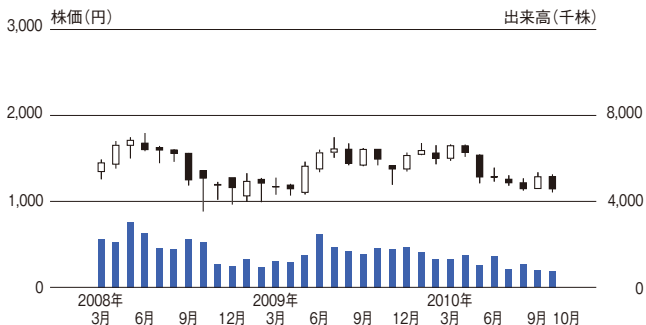
### 大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	2,902千株	9.4%
野田 純孝	2,320	7.5
株式会社フジインコーポレーテッド(自己株口)	1,960	6.3
有限会社コマ	1,638	5.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,595	5.1
越山 彰	1,151	3.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,076	3.5
日本生命保険相互会社	779	2.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	728	2.3
株式会社りそな銀行	691	2.2

## 役員 2010年9月30日現在

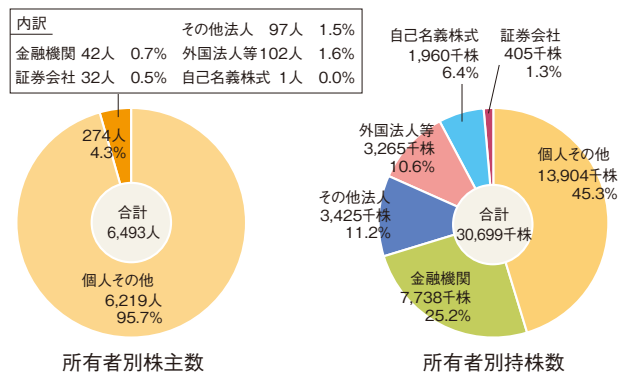
代表取締役社長	関 敬史
取締役	児玉 一志
取締役	松島 伸男
取締役	土屋太加志
取締役	伊藤 広一
常勤監査役	藤本 俊之
常勤監査役	石井 和廣
監査役	鮎澤 多俊
監査役	山下 紀雄

## 株価および出来高の推移



\* 株価データは、株式分割を過年度に遡りして調整した修正株価を使用しています。

## 株主分布状況 2010年9月30日現在



## 会社データ 2010年9月30日現在

商号	株式会社フジミンコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	47億5,343万8,500円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	747名(個別583名)

## 株主メモ 2010年9月30日現在

決算期	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告( <a href="http://www.fujimiinc.co.jp">http://www.fujimiinc.co.jp</a> ) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社
同事務取扱場所	名古屋市中区栄3-7-20 日土地栄町ビル 日本証券代行株式会社 名古屋支店

## 株式会社フジミンコーポレーテッド

お問い合わせ先: 経営企画部企画課  
TEL: 052-503-8181 (代表)  
URL: <http://www.fujimiinc.co.jp>


Copyright (C) 2010 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

## 各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等  
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。  
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

### 【連絡先】

日本証券代行株式会社 代理人部

 0120-707-843



この印刷物は、FSC 認証紙を使用し、植物油 100%の「大豆油インキ」を使い、ISO14001 認証工場において「水なし印刷」で印刷しています。また、省資源化（フィルムレス）に繋がる CTP により製版しています。

